

# CD74HCx4067 高速 CMOS ロジック 16 チャネル アナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサ

## 1 特長

- 幅広いアナログ入力電圧範囲
- 低いオン抵抗
  - $V_{CC} = 4.5V$ 、 $70\Omega$  (標準値)
  - $V_{CC} = 6V$ 、 $60\Omega$  (標準値)
- 高速なスイッチングおよび伝搬速度
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  - $4.5V$  で  $6ns$  (標準値)
- ナロー ボディとワイド ボディ両方のプラスチック パッケージで供給されます
- ファンアウト (全温度範囲にわたって)
  - 標準出力: 10 個の LSTTL 負荷
  - バスドライバ出力: 15 個の LSTTL 負荷
- 広い動作温度範囲:  $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
- HC タイプ
  - $2V \sim 6V$  で動作
  - 優れたノイズ耐性:  $V_{CC}$  に対して  $N_{IL} = 30\%$ 、 $N_{IH} = 30\%$  ( $V_{CC} = 5V$  時)
- HCT タイプ
  - $4.5V \sim 5.5V$  で動作
  - LSTTL 入力ロジックと直接互換、 $V_{IL} = 0.8V$  (最大値)、 $V_{IH} = 2V$  (最小値)
  - CMOS 入力互換、 $V_{OL}$ 、 $V_{OH}$  で  $I_L \leq 1\mu A$

## 2 アプリケーション

- エネルギー インフラ
- ビル オートメーション
- ワイヤレス インフラ
- 家電製品
- データ センターおよびエンタープライズ コンピューティング
- リテール オートメーションと支払い

- 信号ゲーティング
- モジュレータ
- スケルチ制御
- 復調器
- チョッパ
- 整流スイッチ
- A/D 変換および D/A 変換
- 周波数、インピーダンス、位相、アナログ信号ゲインのデジタル制御

## 3 概要

CD74HC4067 および CD74HCT4067 デバイスはデジタル制御のアナログ スイッチで、シリコン ゲート CMOS テクノロジーを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

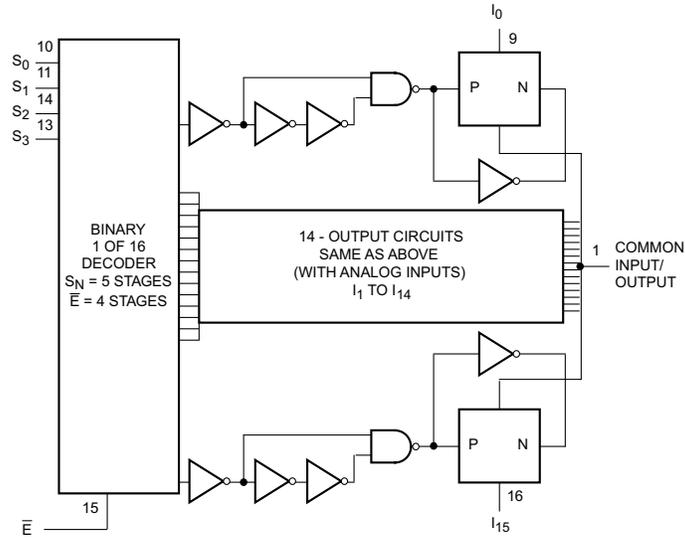
これらのアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これらは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。スイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。さらに、これらのデバイスにはイネーブル制御があり、HIGH のときはすべてのスイッチがオフ状態でディセーブルされます。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ <sup>(1)</sup>	本体サイズ (公称)
CD74HC4067M	SOIC(24)	15.4mm × 10.3mm
CD74HC4067M96	SOIC(24)	15.4mm × 10.3mm
CD74HC4067SM96	SSOP(24)	8.20mm × 7.40mm
CD74HCT4067M	SOIC(24)	15.4mm × 10.3mm
CD74HC4067PW	TSSOP(24)	7.8mm × 6.4mm
CD74HCT4067PW	TSSOP(24)	7.8mm × 6.4mm

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。



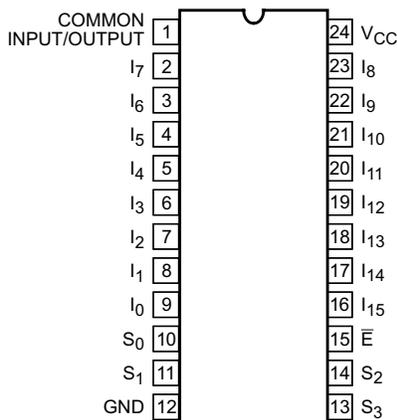


機能ブロック図

## Table of Contents

<b>1 特長</b> .....	<b>1</b>	<b>13 Analog Channel Specifications</b> .....	<b>11</b>
<b>2 アプリケーション</b> .....	<b>1</b>	<b>14 Typical Characteristics</b> .....	<b>12</b>
<b>3 概要</b> .....	<b>1</b>	<b>15 Analog Test Circuits</b> .....	<b>13</b>
<b>4 Pin Configuration and Functions</b> .....	<b>4</b>	<b>16 Device and Documentation Support</b> .....	<b>14</b>
4.1 Device Functional Modes.....	5	16.1 Related Documentation.....	14
<b>5 Absolute Maximum Ratings</b> .....	<b>5</b>	16.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	14
<b>6 Thermal Information</b> .....	<b>6</b>	16.3 サポート・リソース.....	14
<b>7 Recommended Operating Conditions</b> .....	<b>6</b>	16.4 Trademarks.....	14
<b>8 Electrical Characteristics: HC Devices</b> .....	<b>7</b>	16.5 静電気放電に関する注意事項.....	14
<b>9 Electrical Characteristics: HCT Devices</b> .....	<b>8</b>	16.6 用語集.....	14
<b>10 HTC Input Loading</b> .....	<b>8</b>	<b>17 Revision History</b> .....	<b>14</b>
<b>11 Switching Characteristics HC</b> .....	<b>9</b>	<b>18 Mechanical, Packaging, and Orderable Information</b> .....	<b>14</b>
<b>12 Switching Characteristics HCT</b> .....	<b>10</b>		

## 4 Pin Configuration and Functions



☒ 4-1. N, DW, or DB Packages 24-Pin PDIP, SOIC, or SSOP (Top View)

PIN		TYPE <sup>(1)</sup>	DESCRIPTION
NAME	NO.		
COMMON INPUT/OUTPUT	1	IO	Common input or output.
I <sub>7</sub>	2	IO	Switch input/output
I <sub>6</sub>	3	IO	Switch input/output
I <sub>5</sub>	4	IO	Switch input/output
I <sub>4</sub>	5	IO	Switch input/output
I <sub>3</sub>	6	IO	Switch input/output
I <sub>2</sub>	7	IO	Switch input/output
I <sub>1</sub>	8	IO	Switch input/output
I <sub>0</sub>	9	IO	Switch input/output
S <sub>0</sub>	10	I	Select/Address pin
S <sub>1</sub>	11	I	Select/Address pin
GND	12	P	Ground pin
S <sub>3</sub>	13	I	Select/Address pin
S <sub>2</sub>	14	I	Select/Address pin
$\bar{E}$	15	I	Enable for all switches ON/OFF
I <sub>15</sub>	16	IO	Switch input/output
I <sub>14</sub>	17	IO	Switch input/output
I <sub>13</sub>	18	IO	Switch input/output
I <sub>12</sub>	19	IO	Switch input/output
I <sub>11</sub>	20	IO	Switch input/output
I <sub>10</sub>	21	IO	Switch input/output
I <sub>9</sub>	22	IO	Switch input/output
I <sub>8</sub>	23	IO	Switch input/output
V <sub>CC</sub>	24	P	Power pin

(1) I = input, O = output, P = Power

## 4.1 Device Functional Modes

表 4-1. Truth Table

S0	S1	S2	S3	E	SELECTED CHANNEL
X	X	X	X	1	None
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	2
1	1	0	0	0	3
0	0	1	0	0	4
1	0	1	0	0	5
0	1	1	0	0	6
1	1	1	0	0	7
0	0	0	1	0	8
1	0	0	1	0	9
0	1	0	1	0	10
1	1	0	1	0	11
0	0	1	1	0	12
1	0	1	1	0	13
0	1	1	1	0	14
1	1	1	1	0	15

## 5 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)<sup>(1) (2)</sup>

		MIN	MAX	UNIT
V <sub>CC</sub> HC	DC Supply voltage	-0.5	7	V
V <sub>CC</sub> HCT		-0.5	7	V
I <sub>IK</sub>	DC input diode current	For V <sub>I</sub> < -0.5V or V <sub>I</sub> > V <sub>CC</sub> + 0.5V		mA
I <sub>OK</sub>	DC output diode current	For V <sub>O</sub> < -0.5V or V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub> + -0.5V		mA
I <sub>CC</sub>	DC V <sub>CC</sub> or ground current	-50	50	mA
DC Output Source or Sink Current per Output Pin, I <sub>O</sub>	For V <sub>O</sub> > -0.5V or V <sub>O</sub> < V <sub>CC</sub> + -0.5V	-25	25	mA
T <sub>JMAX</sub>	Maximum junction temperature (Plastic Package)		150	°C
T <sub>stg</sub>	Storage temperature	-65	150	°C

- (1) Stresses beyond those listed under *Absolute Maximum Rating* may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, which do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under *Recommended Operating Condition*. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
- (2) All voltages are with respect to ground, unless otherwise specified.

## 6 Thermal Information

THERMAL METRIC <sup>(1)</sup>		CD74HCx4067				UNIT
		E (PDIP)	M (SOIC)	SM (SSOP)	PW (TSSOP)	
		24 PINS	24 PINS	24 PINS	24 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	67	84.8	96.2	97.4	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	Junction-to-case (top) thermal resistance	N/A	57.0	60.0	45.0	°C/W
$R_{\theta JB}$	Junction-to-board thermal resistance	N/A	59.5	65.1	62.7	°C/W
$\Psi_{JT}$	Junction-to-top characterization parameter	N/A	29.0	21.1	5.20	°C/W
$\Psi_{JB}$	Junction-to-board characterization parameter	N/A	59.0	64.4	62.1	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC Package Thermal Metrics](#) application report.

## 7 Recommended Operating Conditions

			MIN	NOM	MAX	UNIT
$V_{CC}$	Supply voltage range ( $T_A$ = full package temperature range)(2)	CD54 and 74HC types	2		6	V
		CD54 and 74HCT types	4.5		5.5	
$V_{IS}$	Analog switch I/O voltage		0		$V_{CC}$	V
$T_A$	Ambient temperature		-55		125	°C
$t_r, t_f$	Input rise and fall times	2 V	0		1000	ns
		4.5 V	0		500	
		6 V	0		400	

## 8 Electrical Characteristics: HC Devices

Over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS				MIN	TYP	MAX	UNIT
<b>Analog Switch</b>									
		$V_{IS}$ (V)	$V_I$ (V)	$V_{CC}$ (V)	$T_A$				
High Level Input Voltage	$V_{IH}$			2	25°C	1.5		V	
					-40°C to +85°C	1.5			
					-55°C to +125°C	1.5			
				4.5	25°C	3.15			
					-40°C to +85°C	3.15			
					-55°C to +125°C	3.15			
				6	25°C	4.2			
					-40°C to +85°C	4.2			
					-55°C to +125°C	4.2			
Low Level Input Voltage	$V_{IL}$			2	25°C		0.5	V	
					-40°C to +85°C		0.5		
					-55°C to +125°C		0.5		
				4.5	25°C		1.35		
					-40°C to +85°C		1.35		
					-55°C to +125°C		1.35		
				6	25°C		1.8		
					-40°C to +85°C		1.8		
					-55°C to +125°C		1.8		
"ON" Resistance IO = 1mA	$R_{ON}$	$V_{CC}$ or GND	$V_{CC}$ or GND	4.5	25°C	70	160	$\Omega$	
					-40°C to +85°C		200		
					-55°C to +125°C		240		
				6	25°C	60	140		
					-40°C to +85°C		175		
					-55°C to +125°C		210		
		$V_{CC}$ to GND	$V_{CC}$ to GND	4.5	25°C	90	180		
					-40°C to +85°C		225		
					-55°C to +125°C		270		
				6	25°C	80	160		
					-40°C to +85°C		200		
					-55°C to +125°C		240		
"ON" Resistance Between Any Two Switches	$\Delta R_{ON}$			4.5	25°C	10	$\Omega$		
				6		8.5			
Off-Switch Leakage Current	$I_Z$	$\bar{E} = V_{CC}$	$V_{CC}$ or GND	6	25°C	$\pm 0.8$	$\mu A$		
					-55°C to 85°C	$\pm 8$			
					-55°C to 125°C	$\pm 8$			
Input Leakage Current (Any Control)	$I_{IL}$		$V_{CC}$ or GND <sup>(1)</sup>	6	25°C	$\pm 0.1$	$\mu A$		
					-55°C to 85°C	$\pm 1$			
					-55°C to 125°C	$\pm 1$			

Over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS				MIN	TYP	MAX	UNIT
Quiescent Device Current	I <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub> or GND	6	25°C				8	μA
				-55°C to 85°C				80	
				-55°C to 125°C				160	

(1) Any voltage between V<sub>CC</sub> and GND.

## 9 Electrical Characteristics: HCT Devices

Over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS				MIN	TYP	MAX	UNIT
<b>Analog Switch</b>									
		V <sub>IS</sub> (V)	V <sub>I</sub> (V)	V <sub>CC</sub> (V)	T <sub>A</sub>				
High Level Input Voltage	V <sub>IH</sub>			4.5	25°C		2		V
					-40°C to +85°C		2		
					-55°C to +125°C		2		
Low Level Input Voltage	V <sub>IL</sub>			4.5	25°C			0.8	V
					-40°C to +85°C			0.8	
					-55°C to +125°C			0.8	
"ON" Resistance IO = 1mA	R <sub>ON</sub>	V <sub>CC</sub> or GND	V <sub>CC</sub> or GND	4.5	25°C		70	160	Ω
					-40°C to +85°C			200	
					-55°C to +125°C			240	
		V <sub>CC</sub> to GND	V <sub>CC</sub> to GND	25°C		90	180	Ω	
				-40°C to +85°C			225		
				-55°C to +125°C			270		
"ON" Resistance Between Any Two Switches	ΔR <sub>ON</sub>			4.5	25°C		10	Ω	
Off-Switch Leakage Current	I <sub>Z</sub>	E = V <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub> or GND	5.5	25°C			±0.8	μA
					-55°C to 85°C			±8	
					-55°C to 125°C			±8	
Input Leakage Current (Any Control)	I <sub>IL</sub>		V <sub>CC</sub> or GND	5.5	25°C			±0.1	μA
					-55°C to 85°C			±1	
					-55°C to 125°C			±1	
Quiescent Device Current	I <sub>CC</sub>		V <sub>CC</sub> or GND	5.5	25°C			8	μA
					-55°C to 85°C			80	
					-55°C to 125°C			160	
Additional Quiescent Device Current Per Input Pin: 1 Unit Load	▲I <sub>CC</sub> (1)		V <sub>CC</sub> - 2.1	4.5 to 5.5	25°C		100	360	μA
					-55°C to 85°C			450	
					-55°C to 125°C			490	

(1) For dual-supply systems theoretical worst case (V<sub>I</sub> = 2.4V, V<sub>CC</sub> = 5.5V) specification is 1.8mA

## 10 HTC Input Loading

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

INPUT	UNIT LOAD <sup>(1)</sup>
S <sub>0</sub> – S <sub>3</sub>	0.5
E	0.3

(1) Unit Load is the ΔI<sub>CC</sub> limit specified in [セクション 9](#) (for example, 360-μA max at 25°C).

## 11 Switching Characteristics HC

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Parameter		Test Conditions		C <sub>L</sub> (pF)	MIN	NOM	MAX	UNIT						
Propagation Delay Time Switch In to Out	t <sub>PHL</sub> , t <sub>PLH</sub>	2	25°C	50				75						
			-40°C to 85°C					95						
			-55°C to 125°C					110						
		4.5	25°C					15						
			-40°C to 85°C					19						
			-55°C to 125°C					22						
		6	25°C					13						
			-40°C to 85°C					16						
			-55°C to 125°C					19						
		5	25°C					15	6					
		Switch Turn On E to Out	t <sub>PZH</sub> , t <sub>PZL</sub>					2	25°C	50				275
									-40°C to 85°C					345
-55°C to 125°C	415													
4.5	25°C			55										
	-40°C to 85°C			69										
	-55°C to 125°C			83										
6	25°C			47										
	-40°C to 85°C			59										
	-55°C to 125°C			71										
5	25°C			15	23									
Switch Turn On Sn to Out	t <sub>PZH</sub> , t <sub>PZL</sub>			2	25°C	50								300
					-40°C to 85°C									375
		-55°C to 125°C	450											
		4.5	25°C	60										
			-40°C to 85°C	75										
			-55°C to 125°C	90										
		6	25°C	51										
			-40°C to 85°C	64										
			-55°C to 125°C	76										
		5	25°C	15	25									
		Switch Turn Off E to Out	t <sub>PHZ</sub> , t <sub>PLZ</sub>	2	25°C					50				275
					-40°C to 85°C									345
-55°C to 125°C	415													
4.5	25°C			55										
	-40°C to 85°C			69										
	-55°C to 125°C			83										
6	25°C			47										
	-40°C to 85°C			59										
	-55°C to 125°C			71										
5	25°C			15	23									

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Parameter		Test Conditions		C <sub>L</sub> (pF)	MIN	NOM	MAX	UNIT			
Switch Turn Off Sn to Out	t <sub>PHZ</sub> , t <sub>PLZ</sub>	2	25°C	50			290	ns			
			-40°C to 85°C				365				
			-55°C to 125°C				435				
		4.5	25°C				58				
			-40°C to 85°C				73				
			-55°C to 125°C				87				
		6	25°C				49				
			-40°C to 85°C				62				
			-55°C to 125°C				74				
		5	25°C	15			21				
		Input (Control) Capacitance	C <sub>I</sub>		25°C					10	pF
					-40°C to 85°C					10	
	-55°C to 125°C						10				
C <sub>PD</sub> Power dissipation capacitance(1)	C <sub>PD</sub>	5	25°C				93				

## 12 Switching Characteristics HCT

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Parameter		Test Conditions		C <sub>L</sub> (pF)	MIN	NOM	MAX	UNIT
		V <sub>CC</sub> (V)	T <sub>A</sub>					
Propagation Delay Time Switch In to Out	t <sub>PHL</sub> , t <sub>PLH</sub>	4.5	25°C	50			15	ns
			-40°C to 85°C				19	
			-55°C to 125°C				22	
		5	25°C	15		6		
Switch Turn On E to Out	t <sub>PZH</sub> , t <sub>PZL</sub>	4.5	25°C	50			60	ns
			-40°C to 85°C				75	
			-55°C to 125°C				90	
		5	25°C	15		25		
Switch Turn On Sn to Out	t <sub>PZH</sub> , t <sub>PZL</sub>	4.5	25°C	50			60	ns
			-40°C to 85°C				75	
			-55°C to 125°C				90	
		5	25°C	15		25		
Switch Turn Off E to Out	t <sub>PHZ</sub> , t <sub>PLZ</sub>	4.5	25°C	50			55	ns
			-40°C to 85°C				69	
			-55°C to 125°C				83	
		5	25°C	15		23		
Switch Turn Off Sn to Out	t <sub>PHZ</sub> , t <sub>PLZ</sub>	4.5	25°C	50			58	ns
			-40°C to 85°C				73	
			-55°C to 125°C				87	
		5	25°C	15		21		

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Parameter		Test Conditions		C <sub>L</sub> (pF)	MIN	NOM	MAX	UNIT
Input (Control) Capacitance	C <sub>I</sub>		25°C				10	pF
			-40°C to 85°C				10	
			-55°C to 125°C				10	
C <sub>PD</sub> Power dissipation capacitance(1)	C <sub>PD</sub>	5	25°C			96		

### 13 Analog Channel Specifications

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Parameter	Test Conditions	V <sub>CC</sub> (V)	HC	HCT	UNIT
Switch Frequency Response Bandwidth at -3dB		4.5	89	89	MHz
Total Harmonic Distortion	1kHz, V <sub>IS</sub> =4V <sub>PP</sub>	4.5	0.051	0.051	%
Switch "OFF" signal feedthrough		4.5	-75	-75	dB
C <sub>I</sub> Switch input capacitance			5	5	pF
C <sub>COM</sub> Common Capacitance			50	50	pF

## 14 Typical Characteristics

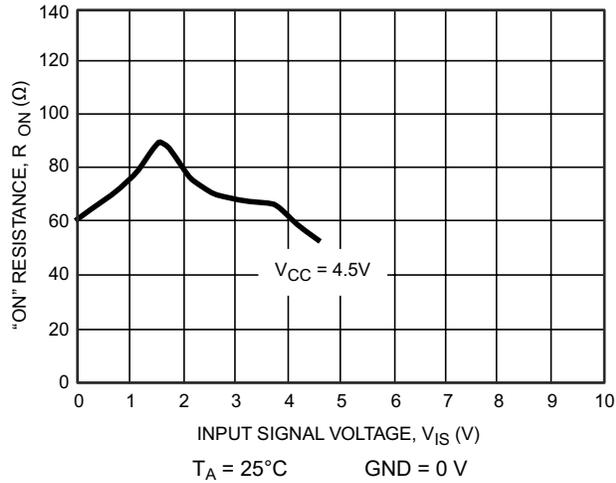


图 14-1. Typical ON Resistance vs Input Signal Voltage

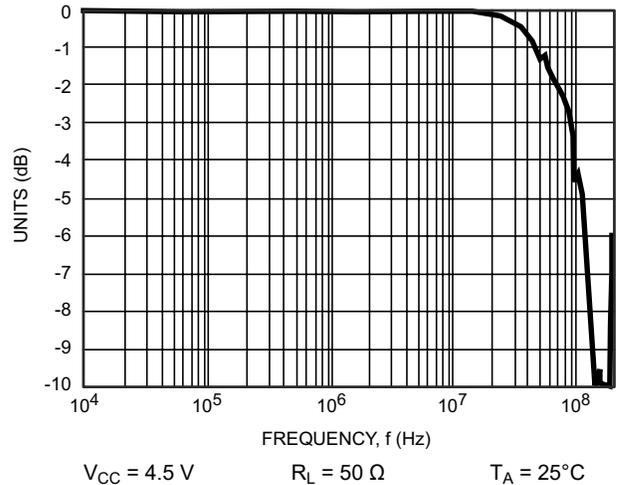


图 14-2. Typical Switch Frequency Response

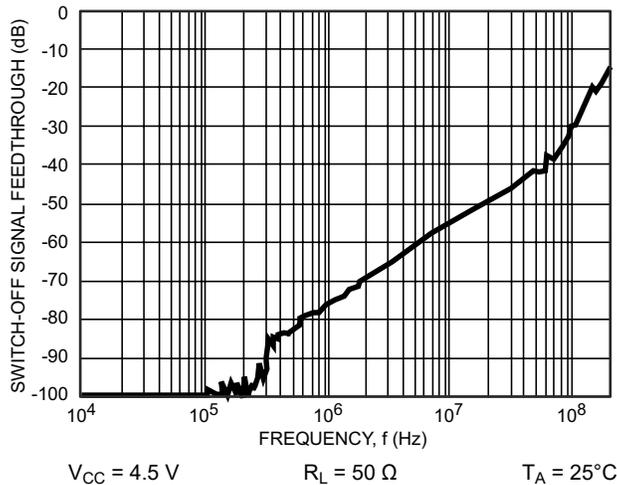
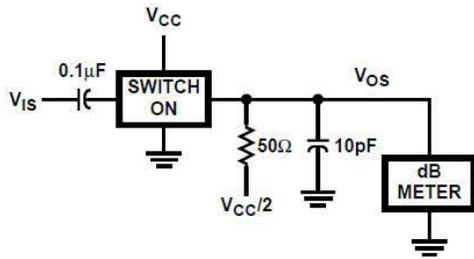
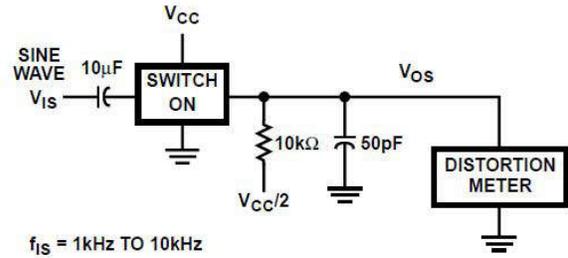


图 14-3. Typical Switch-Off Signal Feedthrough vs Frequency

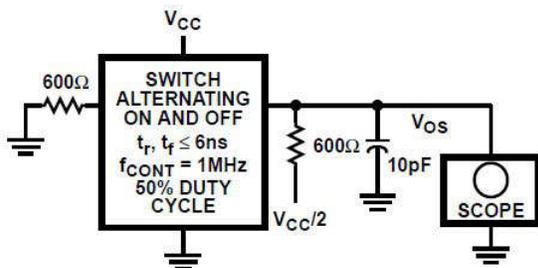
## 15 Analog Test Circuits



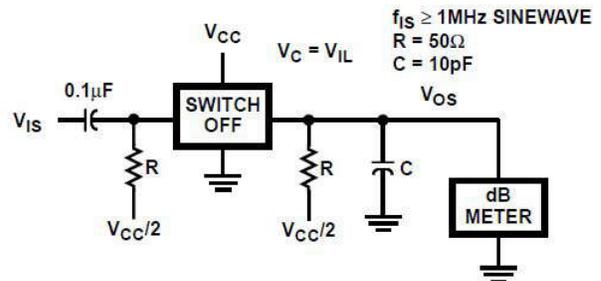
15-1. Frequency Response Test Circuit



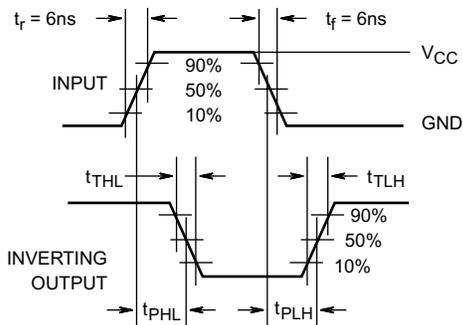
15-2. Sine Wave Distortion Test Circuit



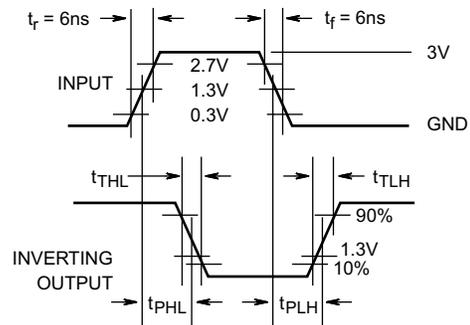
15-3. Control-to-Switch Feedthrough Noise Test Circuit



15-4. Switch Off Signal Feedthrough Test Circuit



15-5. HC Transition Times and Propagation Delay Times, Combination Logic



15-6. HCT Transition Times and Propagation Delay Times, Combination Logic

## 16 Device and Documentation Support

### 16.1 Related Documentation

- Texas Instruments, [High-Speed CMOS Logic 16-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer](#)

### 16.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 16.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 16.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 16.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 16.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 17 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

### Changes from Revision C (November 2003) to Revision D (December 2024)

Page

- 「アプリケーション」、「ピン構成および機能」セクション、ESD 定格の表、熱に関する情報の表、「詳細説明」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを更新 ..... 1

## 18 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">CD74HC4067DGSR</a>	Active	Production	VSSOP (DGS)   24	5000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HC4067
<a href="#">CD74HC4067M96</a>	Active	Production	SOIC (DW)   24	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HC4067M
CD74HC4067M96.A	Active	Production	SOIC (DW)   24	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HC4067M
<a href="#">CD74HC4067PWR</a>	Active	Production	TSSOP (PW)   24	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HC4067
CD74HC4067PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW)   24	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HC4067
<a href="#">CD74HC4067RGYR</a>	Active	Production	VQFN (RGY)   24	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 125	HC4067
CD74HC4067RGYR.A	Active	Production	VQFN (RGY)   24	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	HC4067
<a href="#">CD74HC4067SM96</a>	Active	Production	SSOP (DB)   24	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HP4067
CD74HC4067SM96.A	Active	Production	SSOP (DB)   24	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HP4067
CD74HC4067SM96E4	Active	Production	SSOP (DB)   24	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HP4067
CD74HC4067SM96G4	Active	Production	SSOP (DB)   24	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HP4067
<a href="#">CD74HCT4067DGSR</a>	Active	Production	VSSOP (DGS)   24	5000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HT4067
<a href="#">CD74HCT4067M</a>	Active	Production	SOIC (DW)   24	25   TUBE	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HCT4067M
CD74HCT4067M.A	Active	Production	SOIC (DW)   24	25   TUBE	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HCT4067M
CD74HCT4067ME4	Active	Production	SOIC (DW)   24	25   TUBE	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HCT4067M
CD74HCT4067MG4	Active	Production	SOIC (DW)   24	25   TUBE	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HCT4067M
<a href="#">CD74HCT4067PWR</a>	Active	Production	TSSOP (PW)   24	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HCT4067
CD74HCT4067PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW)   24	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCT4067
<a href="#">CD74HCT4067RGYR</a>	Active	Production	VQFN (RGY)   24	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 125	HCT4067
CD74HCT4067RGYR.A	Active	Production	VQFN (RGY)   24	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	HCT4067

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF CD74HC4067, CD74HCT4067 :**

- Automotive : [CD74HC4067-Q1](#), [CD74HCT4067-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**

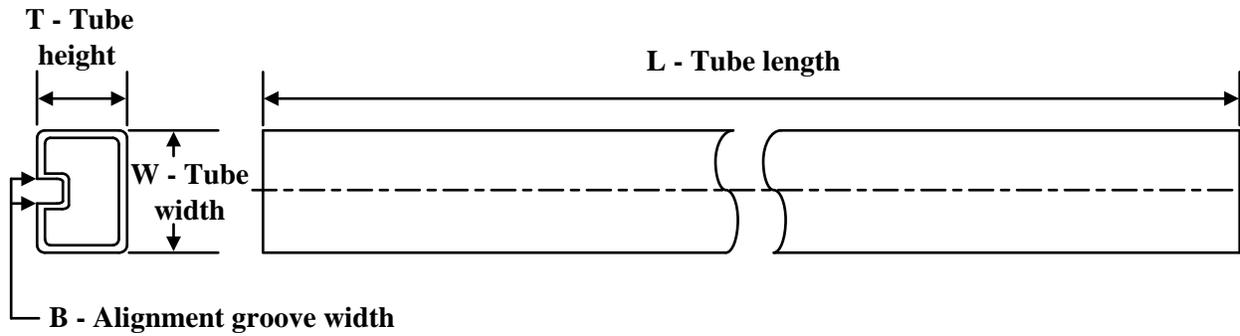

\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CD74HC4067DGSR	VSSOP	DGS	24	5000	330.0	16.4	5.44	6.4	1.45	8.0	16.0	Q1
CD74HC4067M96	SOIC	DW	24	2000	330.0	24.4	10.75	15.7	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74HC4067PWR	TSSOP	PW	24	2000	330.0	16.4	6.95	8.3	1.6	8.0	16.0	Q1
CD74HC4067RGYR	VQFN	RGY	24	3000	330.0	12.4	3.8	5.8	1.2	8.0	12.0	Q1
CD74HC4067SM96	SSOP	DB	24	2000	330.0	16.4	8.2	8.8	2.5	12.0	16.0	Q1
CD74HCT4067DGSR	VSSOP	DGS	24	5000	330.0	16.4	5.44	6.4	1.45	8.0	16.0	Q1
CD74HCT4067PWR	TSSOP	PW	24	3000	330.0	16.4	6.95	8.3	1.6	8.0	16.0	Q1
CD74HCT4067RGYR	VQFN	RGY	24	3000	330.0	12.4	3.8	5.8	1.2	8.0	12.0	Q1

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CD74HC4067DGSR	VSSOP	DGS	24	5000	353.0	353.0	32.0
CD74HC4067M96	SOIC	DW	24	2000	350.0	350.0	43.0
CD74HC4067PWR	TSSOP	PW	24	2000	353.0	353.0	32.0
CD74HC4067RGYR	VQFN	RGY	24	3000	367.0	367.0	35.0
CD74HC4067SM96	SSOP	DB	24	2000	353.0	353.0	32.0
CD74HCT4067DGSR	VSSOP	DGS	24	5000	353.0	353.0	32.0
CD74HCT4067PWR	TSSOP	PW	24	3000	353.0	353.0	32.0
CD74HCT4067RGYR	VQFN	RGY	24	3000	367.0	367.0	35.0

**TUBE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
CD74HCT4067M	DW	SOIC	24	25	506.98	12.7	4826	6.6
CD74HCT4067M.A	DW	SOIC	24	25	506.98	12.7	4826	6.6
CD74HCT4067ME4	DW	SOIC	24	25	506.98	12.7	4826	6.6
CD74HCT4067MG4	DW	SOIC	24	25	506.98	12.7	4826	6.6

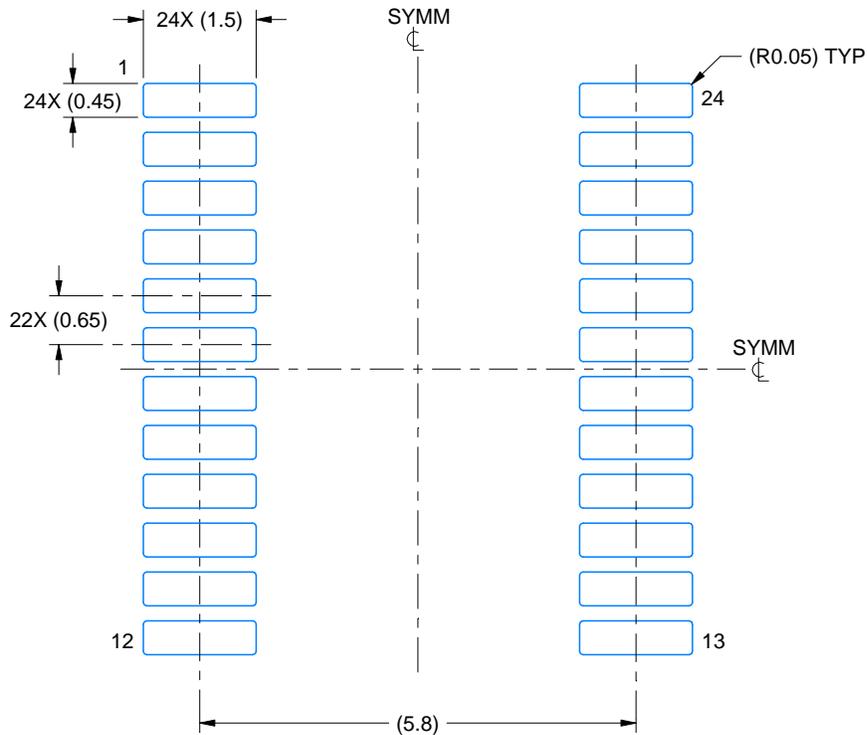


# EXAMPLE BOARD LAYOUT

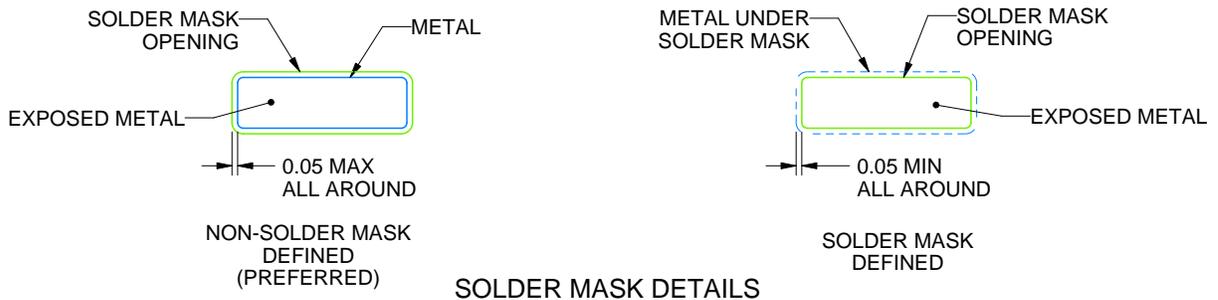
PW0024A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220208/A 02/2017

NOTES: (continued)

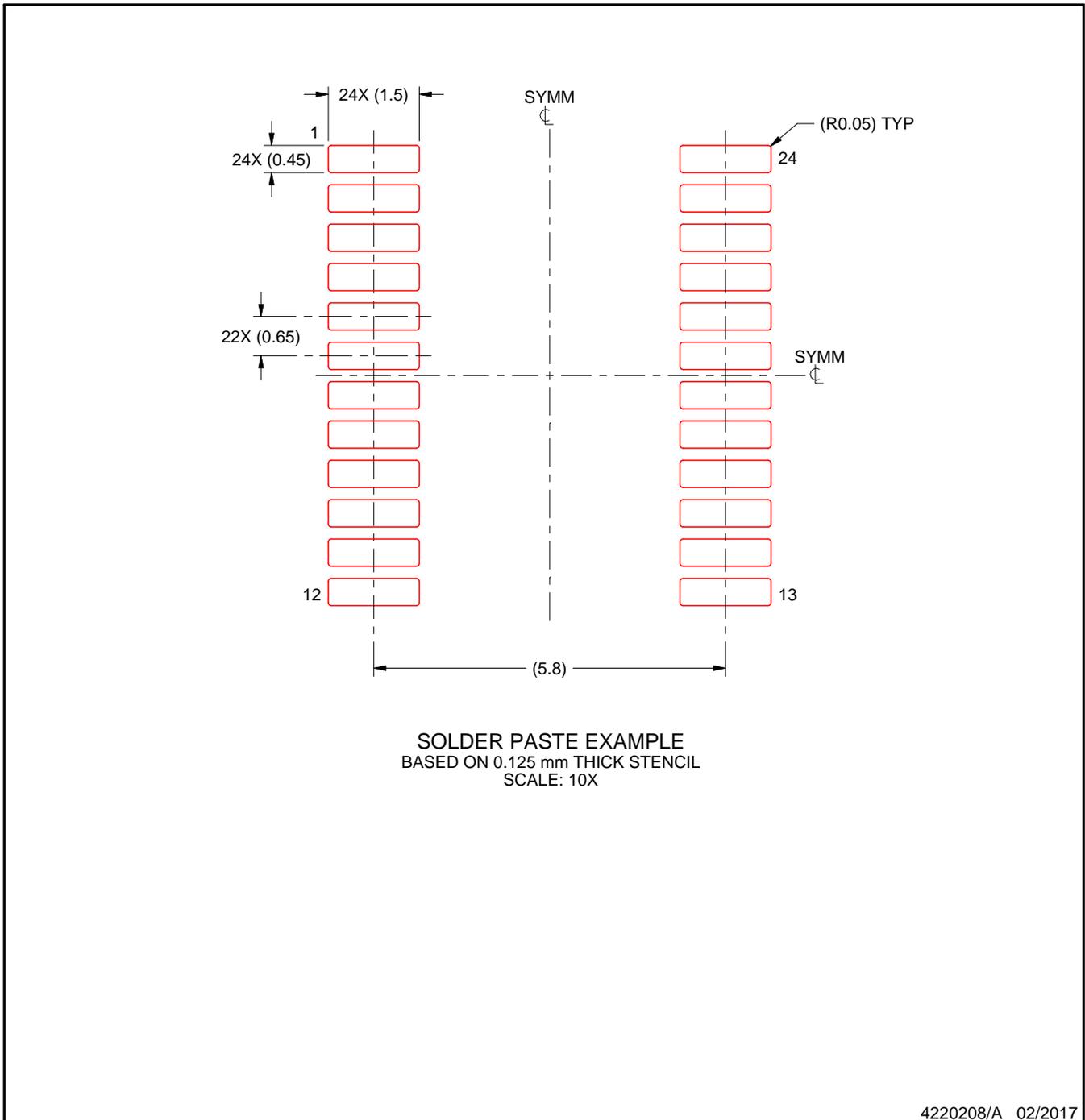
- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0024A

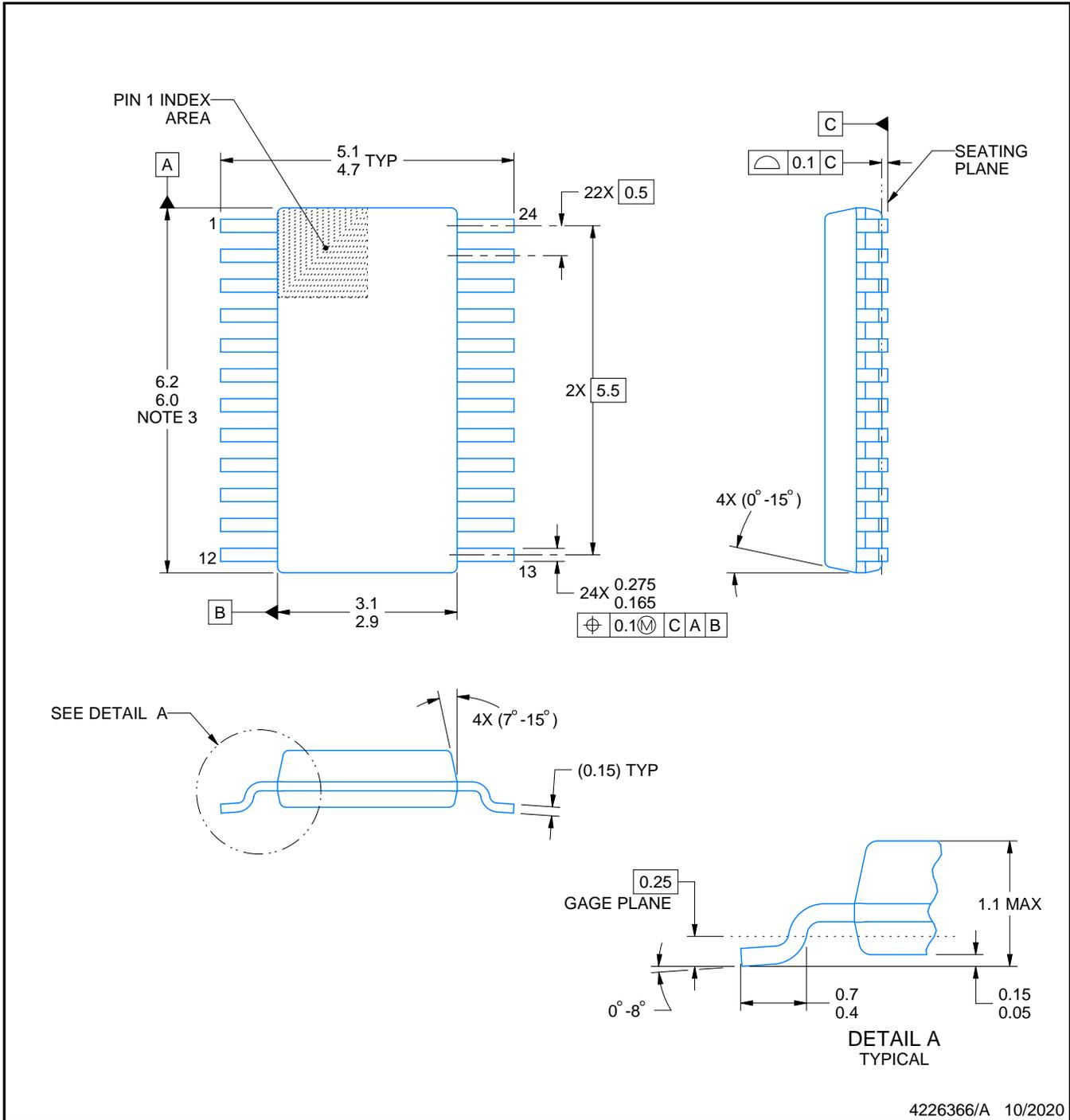
TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



4226366/A 10/2020

NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

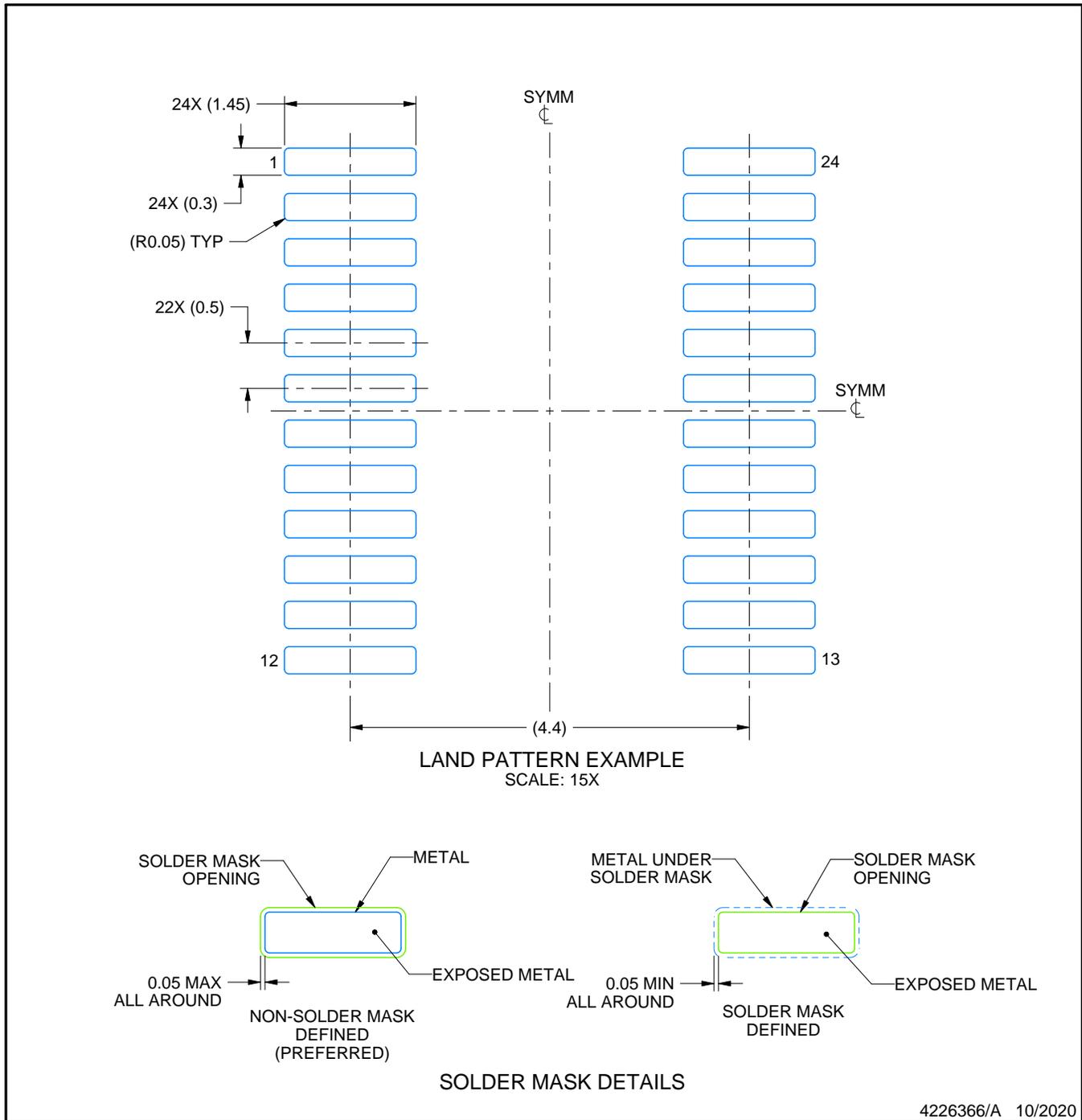
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. No JEDEC registration as of September 2020.
5. Features may differ or may not be present.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DGS0024A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES: (continued)

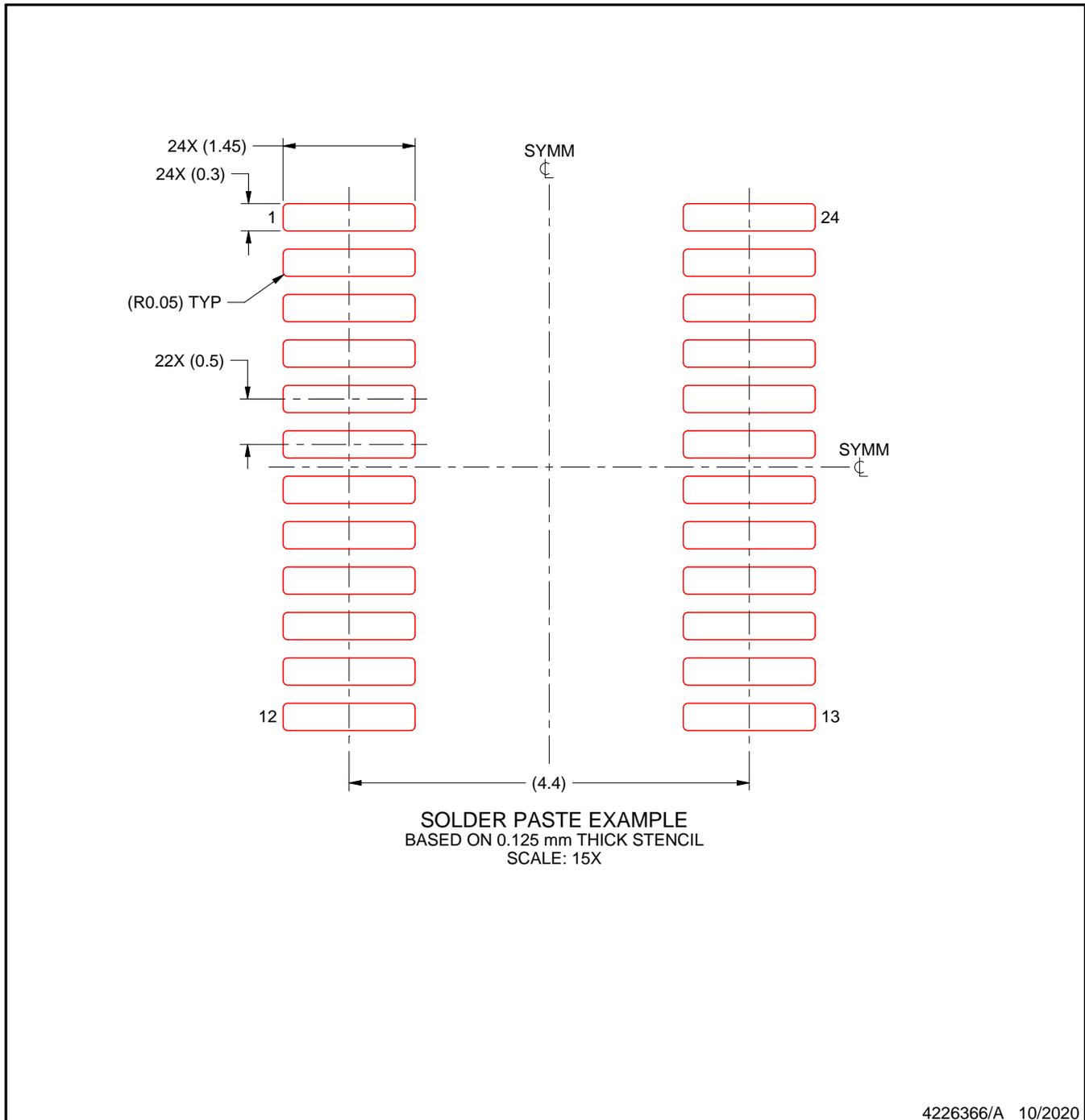
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature numbers SLMA002 ([www.ti.com/lit/slma002](http://www.ti.com/lit/slma002)) and SLMA004 ([www.ti.com/lit/slma004](http://www.ti.com/lit/slma004)).
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.
10. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DGS0024A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES: (continued)

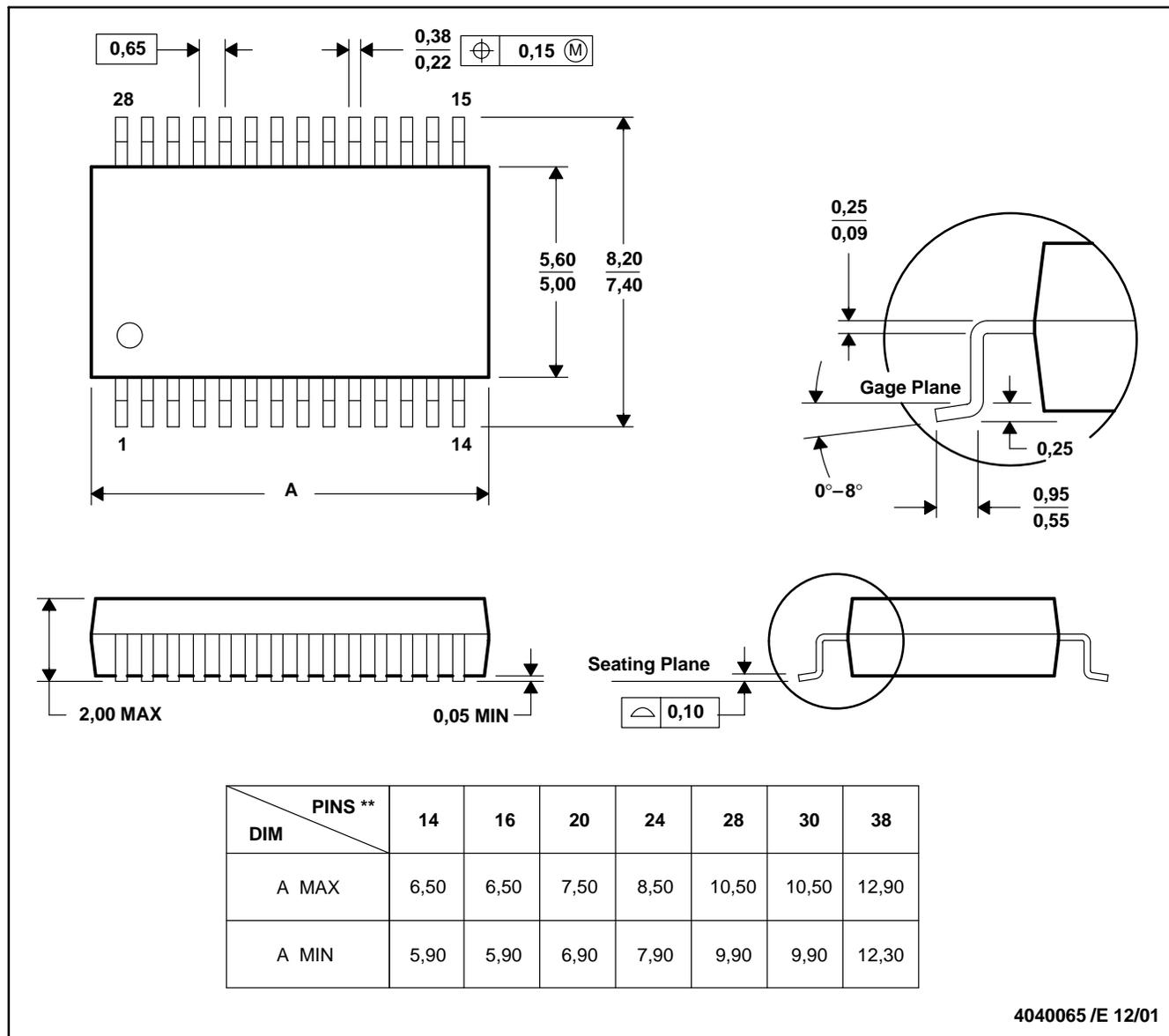
11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



DB (R-PDSO-G\*\*)

PLASTIC SMALL-OUTLINE

28 PINS SHOWN



- NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.  
 B. This drawing is subject to change without notice.  
 C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.  
 D. Falls within JEDEC MO-150

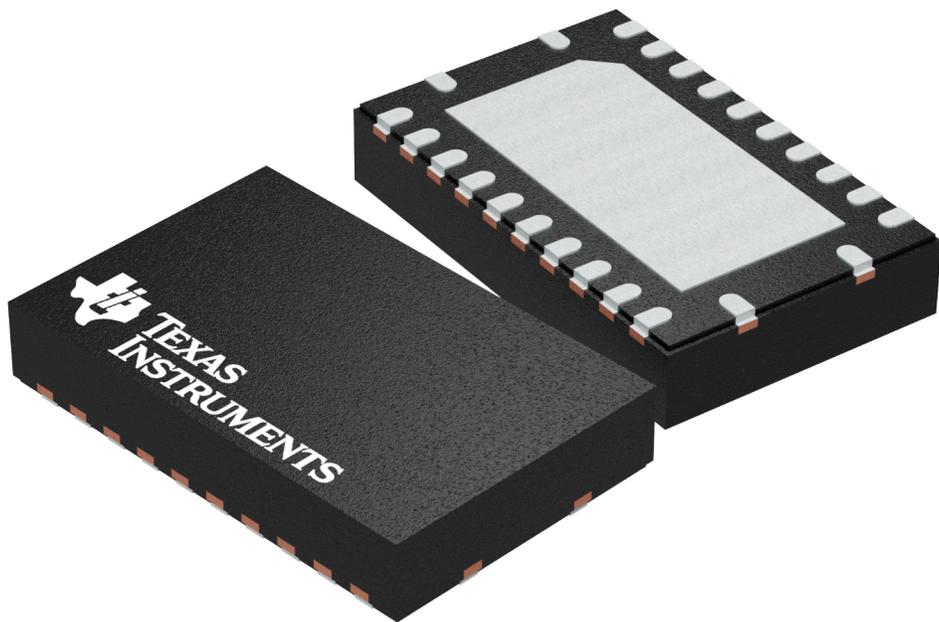
**GENERIC PACKAGE VIEW**

**RGY 24**

**VQFN - 1 mm max height**

**5.5 x 3.5 mm, 0.5 mm pitch**

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

4203539-5/J

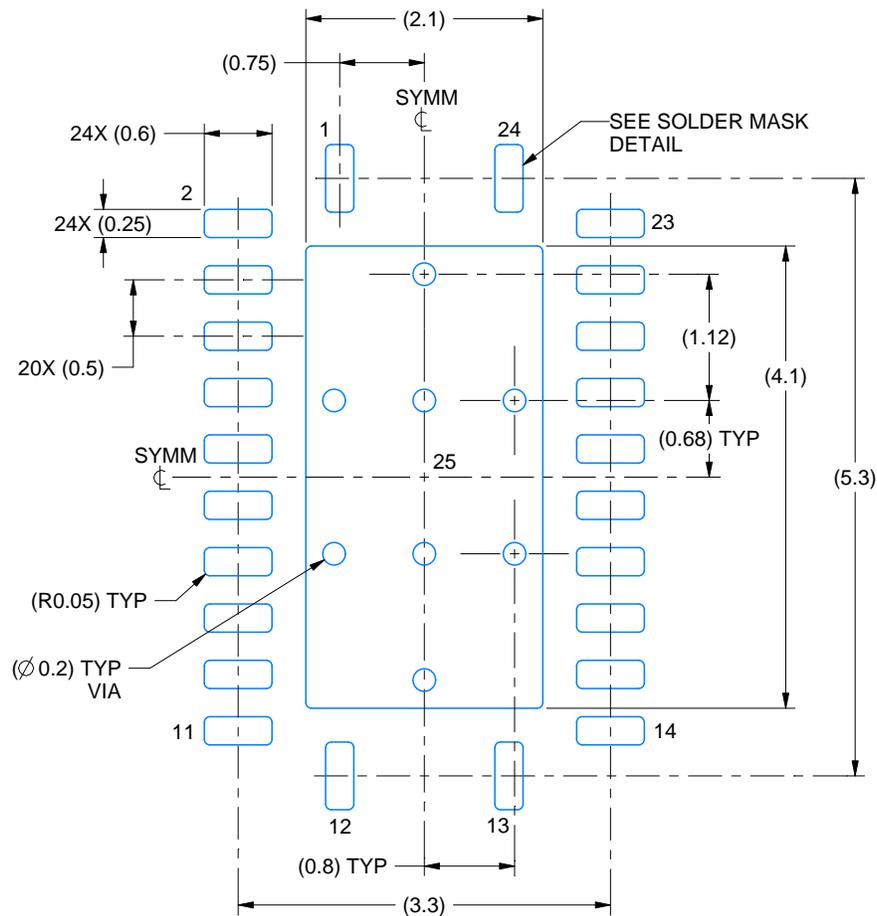


# EXAMPLE BOARD LAYOUT

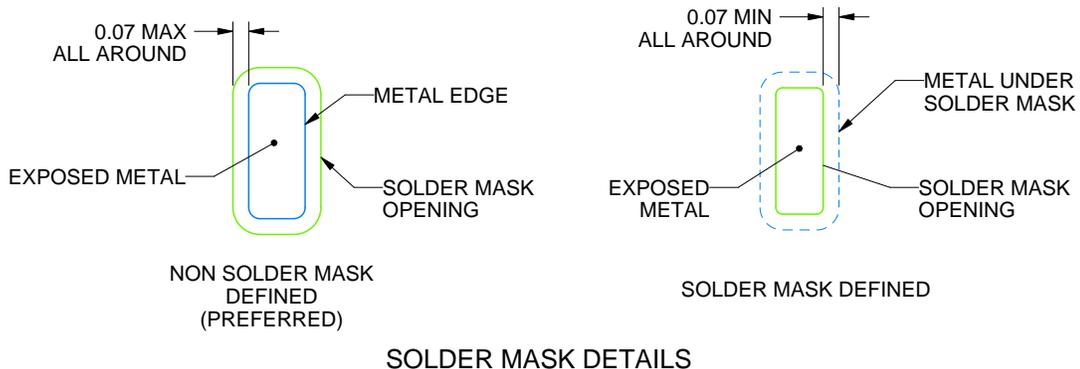
RGY0024F

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 15X



4227032/A 08/2021

NOTES: (continued)

- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/slua271](http://www.ti.com/lit/slua271)).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月